



PRESSEMITTEILUNG

Große Nachfrage nach Unternehmensanleihe der SiC Processing GmbH

- **Mehr als 50 Prozent der 100-Millionen-Euro-Anleihe am ersten Handelstag platziert**
- **SiC-Processing-TechBond mit 7,125 Prozent p. a. über 5 Jahre**

Hirschau, 16.02.2011 – Die SiC Processing GmbH aus Hirschau, Spezialdienstleister für die Photovoltaik-Industrie, hat am ersten Handelstag mehr als 50 Prozent ihrer Unternehmensanleihe SiC-Processing-TechBond (ISIN: DE000A1H3HQ1) platziert. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf insgesamt bis zu 100 Millionen Euro. Die Anleihe wird jährlich fest mit 7,125 Prozent verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Unternehmen wurde von der Ratingagentur Creditreform mit dem Investmentgrade BBB+ bewertet.

Anleger können das Wertpapier direkt bei der Emittentin sowie über ihre Hausbank durch Aufgabe eines Kaufauftrages an der Börse Stuttgart erwerben. Die Anleihe wird voraussichtlich am 1. März 2011 in das Bondm Segment der Börse Stuttgart einbezogen und regulär gehandelt.

Die große Nachfrage nach dem Wertpapier wertet Thomas Heckmann, Gründer und Geschäftsführer der SiC Processing GmbH, als Ausdruck für das Vertrauen in die Strategie des Unternehmens: „Wir wollen die Mittel für das Wachstum in China und Indien nutzen und unsere Forschung und Entwicklung in Deutschland weiter ausbauen.“

In nur zehn Jahren hat sich das Unternehmen mit einem aktuellen Marktanteil von circa 40 Prozent als weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen für die Aufbereitung gebrauchter Sägesuspension (Slurry) aus der Photovoltaik-Industrie etabliert und profitiert von deren weltweitem, nachhaltigen Wachstum. Seit 2007 konnte das Unternehmen seinen Umsatz jährlich um durchschnittlich 54 Prozent auf 160 Millionen Euro in 2010 steigern. Bis 2012 rechnet Thomas Heckmann mit einem Umsatzanstieg auf 300 Millionen Euro. Während das EBITDA (das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) im Jahr 2007 noch neun Millionen Euro betrug, notierte es 2010 mit 51 Millionen Euro bereits fast sechsmal so



hoch. „Bis zum Jahr 2012 wird sich das EBITDA voraussichtlich mehr als verdoppeln“, prognostiziert Heckmann.

Weitere Informationen zum SiC-Processing-TechBond erhalten interessierte Anlegerinnen und Anleger im Anleiheinformationszentrum, montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr, unter der kostenfreien Rufnummer 0800 22 44 060 (innerhalb Deutschlands).

Ein rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt wird unter www.sic-processing.com zum Download und zur kostenlosen Abgabe bei der SiC Processing GmbH, Dienhof 26 in 92242 Hirschau, bereitgehalten.

Eckdaten zum SiC-Processing-TechBond:

Emissionsvolumen:	Bis EUR 100.000.000,00
Stückelung:	EUR 1.000,00
Mindestanlage:	EUR 1.000,00
ISIN:	DE000A1H3HQ1
Laufzeit:	01.03.2011 bis 29.02.2016
Börsennotiz:	Bondm Börse Stuttgart
Zins:	7,125 % p.a.
Zinszahlungen:	jährlich, erstmals zum 01.03.2012
Rückzahlungskurs:	100 %
Wertpapierart:	Inhaber-Teilschuldverschreibung

Über die SiC Processing GmbH:

Mit rund 700 Mitarbeitern steigerte die SiC Processing GmbH den Umsatz im Jahr 2010 um 54 Prozent auf 160 Millionen Euro. Das EBITDA erhöhte sich im selben Zeitraum um 50 Prozent auf 51 Millionen Euro. Derzeit verfügt die SiC Processing GmbH über Produktionsstandorte in Deutschland, China, den USA, Norwegen und Italien mit einer jährlichen Aufbereitungskapazität von 215.000 Tonnen Sägesuspension. Neben dem Mehrheitseigner Nordic Capital Fund VII ist die Gründerfamilie mit 25 Prozent am Unternehmen beteiligt.

Ansprechpartner für Pressefragen : Markus Kreuzer
Marketing and Communications Manager
Telefon: 0049 (0) 9622 - 70 39 273
E-Mail: markus.kreuzer@sic-processing.de